

建構可無限串聯上下游及多變製程跨廠整合計畫

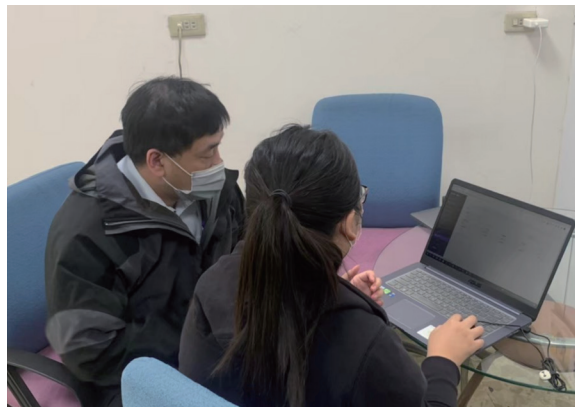
世宣科技股份有限公司

主要營業項目

晶圓研磨 / 切割、晶粒挑選、光學玻璃切割、陶瓷基板切割、PCB板切割、太陽能晶片切割、半導體耗材切割、專利破片加工、單晶片專利二次減薄

計畫緣起

團隊擁有多國發明專利、新型專利以及 ISO 9001、ISO/TS 16949 品質認證，從事積體電路之封裝測試及特殊製程服務代工及電子產品買賣。本計畫平台發想係因目前晶圓加工製程，相關資訊大多封閉，然加工廠一直以來都有資訊需求，藉由本次計畫可達資訊流暢之示範效果。晶圓每段加工製程皆會產生不良品，降低不良率是加工廠努力之目標，然前一段加工廠商若未告知異常處，則可能影響整批產品。因為資訊不共享，將影響整體產業改善空間。透過本計畫平台，其工段內容、照片、檢驗細節皆會主動揭露，對於合作客戶、晶圓製造廠、封測廠皆有益處，達到產業擴散效益。



計畫重點

本計畫平台可依據各站使用者差異，自動產生多條跨廠製造工段，在平台檢視相關資訊時，須輸入廠商編號及訂單編號，揭露資訊加工廠亦須在欲揭露資訊輸入可查閱對象及查閱權限，以維護資訊安全。透過本計畫平台將有效提高晶圓產業加工良品率，且能自由延伸串聯跨廠整合服務，提供選定之上下游廠商查閱資訊權限，做到廠跟廠之間資訊無縫串聯。

計畫創新

1. 建構可無限延伸多條不同上下游廠商及多變製程工段整合作業平台。
2. 根據訂單及上下游廠商名稱，系統可自動產生多條串聯不同跨廠製造工段，且逐一完成各廠工段完工檢驗及廠跟廠之間交貨驗收溝通雙向作業。

